

株主通信

第114期 中間事業報告

2023年4月1日から2023年9月30日まで

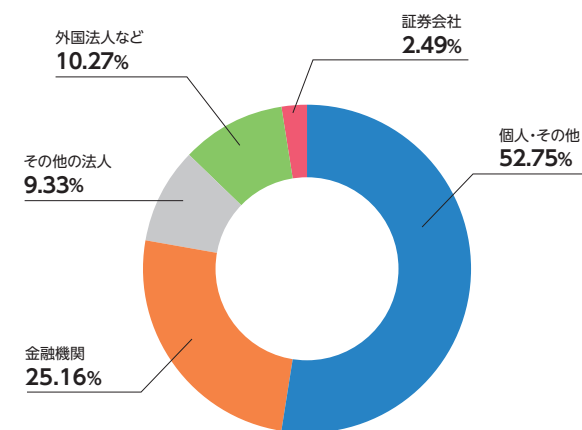


会社の概況 (2023年9月30日現在)

商号 株式会社北川鉄工所 (英文名: Kitagawa Corporation)
本店所在地 広島県府中市元町77-1
設立 1941年11月28日
資本金 86億4千万円
従業員数 1,435名
事業内容 工作機器事業、産業機械事業、金属素形材事業

株式の所有者別状況

発行可能株式総数 普通株式 30,800,000株
発行済株式の総数 普通株式 9,650,803株
株主総数 9,772名
株式の所有者別状況



役員

役職	氏名
代表取締役 会長兼社長執行役員	北川 祐治
代表取締役 副会長執行役員	北川 宏
取締役 上席執行役員	門田 廣夫
社外取締役	西川三佐子
社外取締役	杉口 安弘
社外取締役(常勤監査等委員)	野上 武志
社外取締役(監査等委員)	貝原 潤司
社外取締役(監査等委員)	平 浩介

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	946	10.26
北川鉄工所みのり会	684	7.42
株式会社広島銀行	446	4.83
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	336	3.64
北川鉄工所自社株投資会	252	2.74
みずほ信託銀行株式会社	230	2.49
秋元 利規	200	2.17
朝日生命保険相互会社	171	1.86
損害保険ジャパン株式会社	156	1.70
北川 祐治	136	1.48

(注) 1 当社は自己株式(419,742株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2 持株比率は自己株式(419,742株)を控除して計算しております。
3 北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月下旬
剰余金の配当基準日	期末配当 3月31日
配当金受領株主確定日	中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および特別口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社
お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(通話料無料) ※土・日・祝日を除く9:00～17:00 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324(通話料無料) ※土・日・祝日を除く9:00～17:00
公告方法	当社ホームページにて電子公告しますが、やむをえない事由によって電子公告できない場合は、日本経済新聞に掲載して公告いたします。

住所・氏名の変更、配当金の受領方法の指定・変更、単元未満株式の買取・買増請求等の手続きのご案内

株主様が口座を開設されている証券会社にお申出ください。なお、特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社(左記のお問合せ先)にお申出ください。みずほ信託銀行国内本支店(トラストラウンジを除く)においてもお取扱いたします。

未払配当金の支払いに関するお問合せ先

みずほ信託銀行国内本支店にてお支払いいたします。また、みずほ銀行国内本支店にてお取次ぎのみ可能です。

株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)に関するお問合せ先

お取引の証券会社またはみずほ信託銀行(左記の電子提供制度専用ダイヤル)までお問合せください。

特別口座をご利用の株主様へ

特別口座に記録されている株式は、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買ができません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続きを行っていただく必要があります。お手続きについては、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行(左記のお問合せ先)にお問合せください。

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜わり、厚くお礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化、世界的な金融引締め等の影響により欧州・中国は足踏み状態ですが、全体としては緩やかに回復しています。また、国内においても、消費者物価の上昇や海外景気の下振れが国内景気を下押しするリスクはあるものの、回復基調で推移しました。

このような状況のなか、当社グループは長期経営計画「Plus Decade 2031」で掲げる世界基準の成長を目指し、事業構造の転換、経営品質の進化、人材育成などの施策を中長期的な視野で推進してまいりました。そして、当社グループは成長分野である半導体関連事業に参入すべく、ケメット・ジャパン株式会社及びシステム精工株式会社の全株式を取得いたしました。また、当社は、10月20日に当社株式の上場市場区分を、東京証券取引所プライム市場から同取引所スタンダード市場へ変更をいたしました。

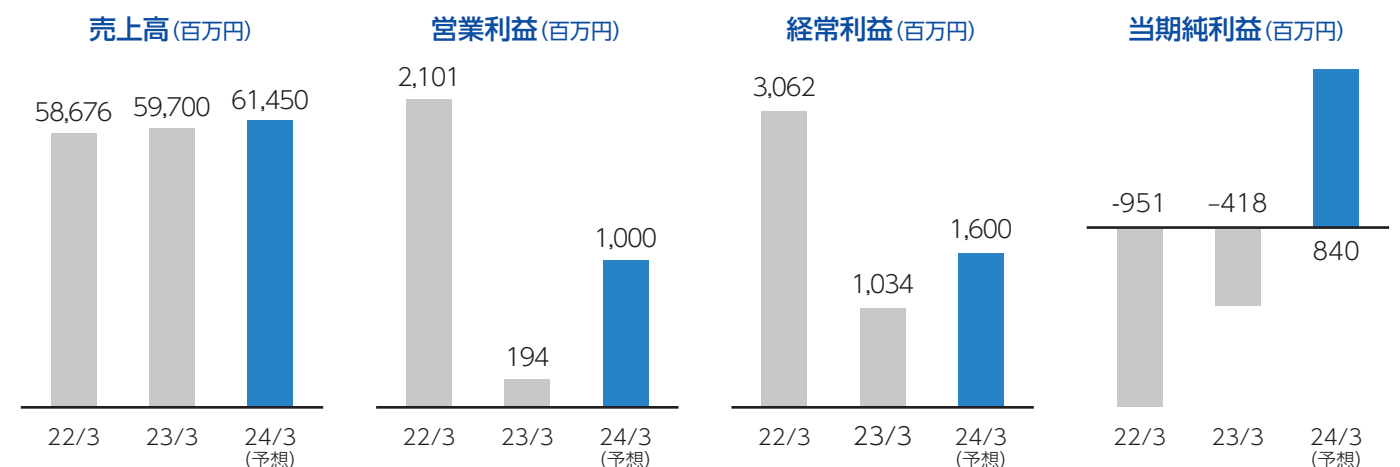
当中間期の配当金につきましては、業績を鑑み無配当とさせていただきます。なお、当期末には1株あたり30円の配当を予定しております。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長兼社長執行役員 北川 祐治



連結決算ハイライト



インターネット上で、いつでも最新のkitagawa情報をご覧いただけます

[https:// www.kiw.co.jp /](https://www.kiw.co.jp/)



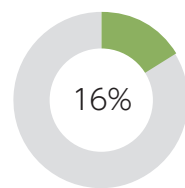
第2四半期 セグメント別の概況

キタガワ グローバル ハンド カンパニー(工作機器事業)

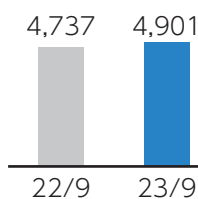
工作機械業界は、電気自動車(EV)関連の設備投資の落ち着きや景気減速の影響により後退しています。内需につきましては、半導体製造装置や自動車関連の設備投資が引き続き低調に推移するなど市況はいまだに低迷しています。外需につきましても、中国市場の景気減退や世界的な金利上昇による設備投資の抑制等の影響もあり減速感が強まりました。

このような状況のもと、当カンパニーでは既存顧客との関係強化に加え、メキシコやインドを中心に海外販売網の拡大を図ってまいりました。また、エネルギー価格や原材料価格の高騰分を販売価格に転嫁するとともに経費削減や社外流出費用の抑制などキャッシュ・フローの改善に努めてまいりました。

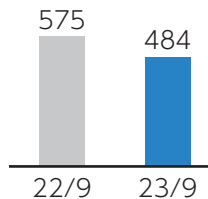
売上高構成比率



売上高(百万円)



営業利益(百万円)



工作機器



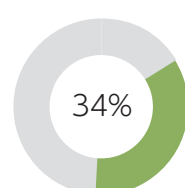
産業ロボット用グリッパ

キタガワ サン テック カンパニー(産業機械事業)

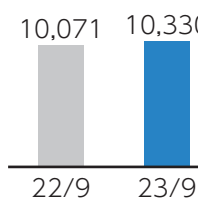
国内の建設業界は、公共投資につきましては「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を背景に防災・減災対策、都市開発などを中心に底堅く推移しています。また、民間建設投資につきましても、一部で弱含みがみられるものの企業収益の改善等を背景に回復傾向で推移しました。

このような状況のもと、当カンパニーでは環境問題に対応した新たなコンクリートプラント設備の開発、ビル建設用クレーンの技術を活用した商品開発による新市場の開拓、スーパーロングスパンタイプ立体駐車場の拡販に努めてまいりました。なお、2023年8月には、送電網強化の工事で需要が見込まれる鉄塔建設用タワークレーン「JCT036」の販売を開始いたしました。

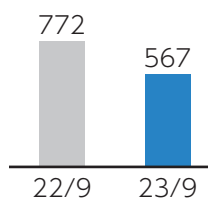
売上高構成比率



売上高(百万円)



営業利益(百万円)



コンクリートプラント



荷役機械



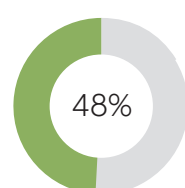
自走式立体駐車場

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー(金属素形材事業)

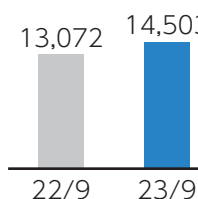
自動車業界は、部品の供給不足の問題が解消されつつあり、世界の自動車販売台数は前年同四半期比で概ね増加で推移しました。一方、農業機械・建設機械業界につきましては、北米の金利上昇や中国でのエンジン需要の低下などの影響により市場が弱含みで推移しており、先行き不透明な状態です。

このような状況のもと、当カンパニーでは高騰した原材料およびエネルギー価格の販売価格への転嫁、生産コストの低減を推進し、収益確保に努めてまいりました。また、メキシコ子会社では自動車のEV化が進展する中でも継続的に需要が見込める駆動系部品の受注に注力してまいりました。

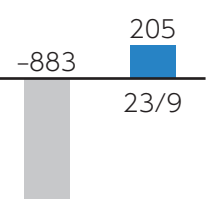
売上高構成比率



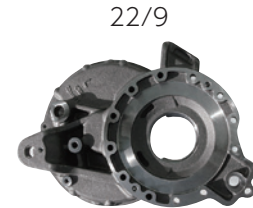
売上高(百万円)



営業利益(百万円)



建設機械部品



農業機械部品

トピックス

半導体市場へ参入 2社を連結子会社化

当社は、2021年に発表した長期経営計画「Plus Decade 2031」に基づき、成長市場である半導体産業へ参入するため、半導体研磨材の製造・販売を行っているケメット・ジャパン株式会社および半導体精密研磨の技術を保有するシステム精工株式会社の株式を2023年7月31日付けで100%取得し、連結子会社化いたしました。

ケメット・ジャパン株式会社

イギリスKemet社の日本総代理店として2002年に創業し、研磨用消耗品の輸入販売を中心に事業を展開。

ダイヤモンドスラリーを代表とした精密研磨用の各研磨材や研磨装置などの関連製品の輸入販売を行うほか、ラップ研磨やCMP研磨、ダイシングなど複数の工程でプロセスの開発や受託加工などの事業も行っています。



ダイヤモンドスラリーなどの研磨材

システム精工株式会社

世界トップレベルの平面研磨技術で、HDDと半導体製造装置の開発、製造を行っています。世界で初めてHDD用磁気ディスクの自動製造装置の開発に成功。高品質なディスクの大量生産を実現し、世界トップシェアを獲得。

光学を中心とした幅広い知見と応用力で、医療、食品、電気自動車など様々な市場で技術を展開しています。



半導体製造装置

2社は、すでに半導体研磨プロセスの開発を研磨材から装置まで一括で受託する事業において協業関係にあり、半導体製造業者を中心とした顧客から高い評価を得ております。

キタガワ グローバル ハンド カンパニーでは、半導体業界向けの商品開発や拡販など、多くのシナジーが得られることも期待しております。

今後は、半導体製造装置の開発を進め、研磨工程全体を支えるメーカーとして、キタガワグループ全体のさらなる成長を目指してまいります。